证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材

**陕西斯瑞新材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**（2024年第三季度业绩说明会）**

编号：2024-024

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会  新闻发布会 路演活动  现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） |
| **形式** | 现场 网上 电话会议 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 |
| **时间** | 2024年11月20日 14:00-15:00 |
| **地点** | 价值在线（www.ir-online.cn） |
| **上市公司接**  **待人员姓名** | 总经理：张航  董事会秘书：徐润升  财务总监：任磊  独立董事：李静 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、目前公司面对的风险点主要有哪些，有哪些具体的应对措施来降低这些风险？**  答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。通常组织运营过程中面临的方向有技术风险、经营风险、内控风险、财务风险等。为了应对各类风险，公司建立了完善的战略管理体系，强化战略规划对公司发展的引领作用，同时基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时高效地制定、优化符合公司实际的发展战略，为公司提供明确的发展目标和方向，构建可持续发展的战略领先优势。未来，公司将充分立足自己的优势业务，突出发展重点，保持并进一步发展公司主营业务，提升公司盈利能力。  公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了公司经营管理和内部控制的基础。公司将持续提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营过程中的风险。  祝您投资愉快！  **2、请问贵公司近几年的发展规划是怎样的**  答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注，上市以来，公司持续按照科创板的定位要求，坚持四个面向，坚定围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，积极应对市场新需求和产业新方面，扎实落实证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中的各项要求，推动公司加强市值管理，不断提升投资价值，努力做到以下几个方面：  1、把握产业根基，继续推动公司基本盘业务稳健增长；  2、持续推进落实公司重点项目建设；  3、支持控股子公司扩产，满足行业快速增长的市场需求；  4、提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，努力实现经营目标；  5、积极布局海外业务，全面推进企业国际化；  6、加快公司新质生产力建设，为未来的产业布局打好基础；  7、全面提升企业管理水平，推进企业可持续高质量发展；  8、强化信息披露，合法合规运营；  9、落实股东大会各项决议；  10、积极维护股东利益，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台。  祝您投资愉快！  **3、公司在研发投入上同比增长了26.34%，请问这些投入主要集中在哪些领域？**  答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注， 2024年前三季度，公司研发投入5,065.39万元，去年同期研发投入4,009.36万元，同比增加1,056.03万元，同比增长26.34%。 公司作为科创板的上市公司，始终坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的定位，不断研发新的产品、新的技术、新的工艺，为公司长期可持续发展提供动力。 本期研发投入主要集中在液体火箭发动机推力室内壁材料、医疗CT球管零组件新产品、3D打印技术研究等领域。  祝您投资愉快！  **4、我看到报表显示归属于上市公司股东的净利润增长了41.23%，能否详细解释这一增长的主要驱动因素？**  答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注，归属于上市公司股东的净利润增长41.23%主要系：  （1）公司积极开拓国际市场，出口收入明显增长，销售结构不断优化；  （2）公司持续加大研发投入，促进经营提质增效，产品毛利率稳步提升；  （3）商业航天等公司新的产业方向快 速增长，逐步开始贡献效益。  祝您投资愉快！  **5、公司在核电方向的客户有哪些**  答：投资者您好！感谢您对公司的关注。 在核电方向，公司研发的特种铜合金具有高导电、高强度的特性，核电发电机用特种铜合金及其零部件的开发已完成，并向下游客户实现小批量供应，目前客户有东方电气等。祝您投资愉快！  **6、公司产品是否可以应用于半导体领域**  答：投资者您好！感谢您的关注。公司产品在半导体领域的应用主要有以下几个方向：  1、公司生产的光模块芯片基座是光模块核心部件光芯片的载体材料，可以应用于400G、800G、1.6T的光模块。  2、公司开发了芯片半导体设备水冷组件，已通过下游龙头客户产品验证并实现批量供货。  3、公司的高强高导铜合金制品可应用于半导体靶材配套零组件。  祝您投资愉快！ |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年11月20日 14:00-15:00 |
| **备注** | 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。 |